

Board to Board Connector

00000000000000

5647 Series

シリーズ (Series)	5647
基板間高さ (Stacking Height)	7.0mm
極間隔 (Pitch)	0.5mm
極数 (No. of Positions)	240 Pos.
定格電流 (Rated Current)	DC 0.4A/Contact
定格電圧 (Rated Voltage)	DC 50V/Contact
耐電圧 (D. W. Voltage)	AC 500Vrms/min.
コンタクト材質 (Contact Material)	銅合金 (Copper alloy)
インシュレータ材質 (Insulator Material)	耐熱樹脂 (Heat-resistant plastic)
使用温度範囲 (Operating Temperature)	-25 to +85℃



◆概要

5647 シリーズは、市場の高密度実装の要求、特に表示機等の 超多極の要求に基づき開発された基板対基板コネクタです。

◆特長

- (1) 多極でありながら優れた実装安定性と嵌合安定性を実現し、 半田上がりを防止する構造を採用しました。
- (2) ハードトレー梱包で、吸着テープの有無が選択可能です。
- (3) 20 個入りのトレイ梱包でお届けします。
- (4) 環境に優しい RoHS 指令対応品です。

Outline

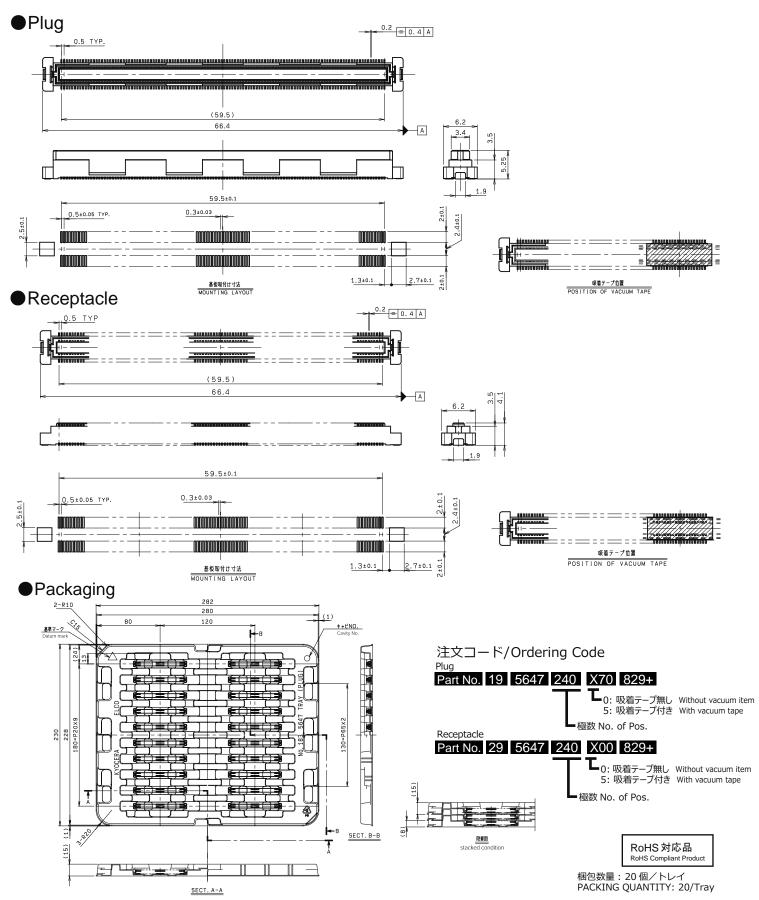
The 5647 Series are Board to Board Connectors developed to meet market demands of high-density packaging and ultra high pin counts, especially for display units.

Features

- (1) Highly stable in mounting and mating occasions despite its high pin counts. Furthermore, the connector features a structure which prevents solder-wicking.
- (2) Available in hard trays with vacuum tapes as options.
- (3) Packaged in tray: 20 pieces/tray.
- (4) RoHS compliant product.

005A-1608-0 006A-1608-0 007O-1608-0

0.5mm ピッチ 嵌合高さ 7.0mm SMT 240 極 0.5mm Pitch, Stacking Height=7.0mm, SMT, 240 positions



本カタログには推奨めっきを掲載しております。めっき種類・仕様、ならびに生産対応可能極数については営業部にご確認願います。 Recommended plating types are mentioned in this catalogue. For other plating types and their specifications, and available numbers of positions, please feel free to contact our sales department.